证券代码：300223　　证券简称：北京君正　　公告编号：2015-069

北京君正集成电路股份有限公司
关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）参加工业和信息化部组织的“2015 年工业转型升级智能制造和‘互联网+’行动支撑保障能力工程--安全芯片能力提升及应用方向”公开招标，并成功中标其中的分包项目“智能硬件软硬件一体化安全芯片及其 IP 核”。近日公司收到中华人民共和国财政部拨付的该中标项目补助资金 750 万元。该项目执行期为自收到该笔资金起至 2017 年 6 月，项目将于执行期结束后进行验收。

本次收到的补助资金将根据《企业会计准则》的规定列入递延收益科目，在项目执行期内平均结转入营业外收入，预计对公司 2015 年度利润不会产生重大影响。

该补助资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日